

## 第25回 有機/無機接合研究委員会

日時：2025年6月17日（火）13:00～15:50

場所：日本橋ライフサイエンスビルディング 9階 911-913 会議室（東京都中央区）

### プログラム

---

司会 浅井 竜彦（富士電機(株)）

**13:00～13:10** 委員会議事

**13:10～13:40**

『ケース型パワーモジュールにおける新規封止材料適用に向けた開発』（30分）

.....○松川 和幸、梶 勇輔、河原 史倫、柴田 康平、山本 圭（三菱電機(株)）

**13:40～14:20**

『高分子/無機界面を用いたニューロン模倣デバイスの創成』（40分）

.....○福田 國統、浅川 直紀（群馬大学）

14:20～14:30 休憩

司会 鈴木 孝明（群馬大学）

**14:30～15:10**

『放熱材中のフィラーと樹脂間のフォノン伝導による3次元熱伝達解析』（40分）

.....○荒尾 修、狐塚 勝司、新帯 亮（(株)デンソー）

**15:10～15:50**

『ポリマー/Cu ハイブリッド接合の低温化に向けた新規接着材料の開発』（40分）

.....中村 雄三、大塚 哲史、住藤 夏美、稲田 智士、久宗 穰、○早川 諒  
(三井化学(株))

（ ）内時間は、質疑応答時間を含む

---

※プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

※本研究委員会の資料を無断で転載、引用することを禁止します。

一般社団法人スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会